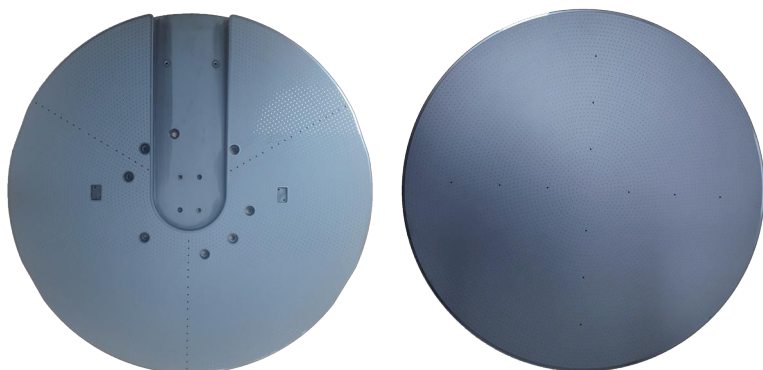




主要特点

- 高导热性、低膨胀系数
- 良好的平面度
- 高刚度, 更优异的耐磨性
- 轻量化设计
- 高纯度, 无金属离子污染
- 可根据用户需求进行结构定制

性能简介

吸盘采用轻量化设计, 并采用和硅材料热膨胀系数相近材料: 无压烧结碳化硅, 渗硅碳化硅, 氮化硅和氮化铝等。吸盘具备高刚度, 高导热, 低热膨胀, 稳定性高等特点, 另外, 还具备高纯度, 晶粒大小均匀等特性, 如此可有效的减少Particle以及化学清洗的污染问题, 延长使用寿命。

主要应用

- 光刻设备
- 半导体量检测设备, 如膜厚测量, OCD 测量, 形貌测量, 缺陷检测等

技术参数

	数据	单位
平面度/Flatness	0.5	μm
适用规格/Applicable specifications	6/8' 12' 8/12'	
表面特征/Surface feature	pin type, ring type	
Pin高度/Pin height	0.05-0.2	mm
Pin直径(最小)/Pin min. diameter	φ0.2	mm
Pin间距(最小)/Min. spacing	3	mm
密环宽度(最小)/Min. seal width	0.7	mm
表面粗糙度/Surface roughness	Ra 0.02	μm
厚度公差/Thickness tolerance	±0.01	mm
直径公差/Diameter tolerance	±0.01	mm
平行度公差/Parallelism tolerance	≤3	μm